(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213513244 U
(45)授权公告日 2021.06.22

(21)申请号 202022862160.0

(22)申请日 2020.12.03

(73)专利权人 杨乐
地址 430000 湖北省武汉市武昌区东湖南路8号

(72)发明人 杨乐

(74)专利代理机构 昆明合众智信知识产权事务所 53113
代理人 潘静

(51)Int.Cl.
F21K 9/20(2016.01)
F21K 9/66(2016.01)
F21V 17/16(2006.01)
F21V 19/00(2006.01)
F21V 3/00(2015.01)
F21V 3/02(2006.01)
F21V 3/06(2018.01)
F21Y 115/10(2016.01)

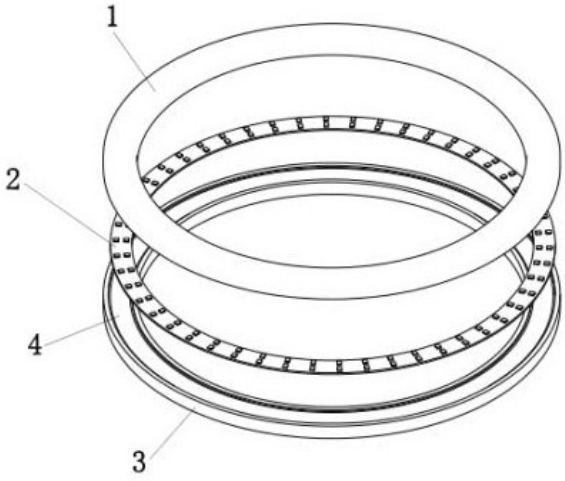
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种LED发光体

(57)摘要

本实用新型公开了一种LED发光体，包括灯罩上壳、LED芯片、灯罩下壳和凹槽，所述灯罩下壳设置在灯罩上壳的底部，所述灯罩上壳和灯罩下壳之间通过扣接固定，所述凹槽开设在灯罩下壳的顶部，所述LED芯片设置在凹槽的内部，所述LED芯片卡接在凹槽的内壁上。本实用新型通过灯罩上壳、LED芯片、灯罩下壳、凹槽相互配合，灯罩上壳和灯罩下壳组成灯罩，灯罩上壳和灯罩下壳之间通过扣接固定，使得灯罩容易拆装，LED芯片卡接在凹槽的内壁上，便于对LED芯片进行拆装，从而方便对LED芯片进行维护，使得对LED芯片的维护工作比较省时省力，降低了工作人员的劳动强度，并且在工艺上，制作简单，美观性好，亮光效果也好，给使用者带来极大的便利。



CN 213513244 U

1.一种LED发光体,其特征在于:包括灯罩上壳(1)、LED芯片(2)、灯罩下壳(3)和凹槽(4),所述灯罩下壳(3)设置在灯罩上壳(1)的底部,所述灯罩上壳(1)和灯罩下壳(3)之间通过扣接固定,所述凹槽(4)开设在灯罩下壳(3)的顶部,所述LED芯片(2)设置在凹槽(4)的内部,所述LED芯片(2)卡接在凹槽(4)的内壁上。

2.根据权利要求1所述的一种LED发光体,其特征在于:所述灯罩上壳(1)和灯罩下壳(3)组成灯罩。

3.根据权利要求1所述的一种LED发光体,其特征在于:所述灯罩上壳(1)和灯罩下壳(3)的外形均设置为环形。

4.根据权利要求1所述的一种LED发光体,其特征在于:所述灯罩上壳(1)和灯罩下壳(3)均由PC材料制成。

一种LED发光体

技术领域

[0001] 本实用新型涉及照明技术领域,具体为一种LED发光体。

背景技术

[0002] 目前,市场上常见的LED芯片安装方式一般将LED芯片贴在一体成型的灯罩内,一体成型的灯罩难以拆卸,不便于对LED芯片进行维护,导致对LED芯片的维护工作比较费时费力,增加了工作人员的劳动强度,给使用者带来极大的不便,为此我们提出一种LED发光体。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种LED发光体,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种LED发光体,包括灯罩上壳、LED芯片、灯罩下壳和凹槽,所述灯罩下壳设置在灯罩上壳的底部,所述灯罩上壳和灯罩下壳之间通过扣接固定,所述凹槽开设在灯罩下壳的顶部,所述LED芯片设置在凹槽的内部,所述LED芯片卡接在凹槽的内壁上。

[0005] 优选的,所述灯罩上壳和灯罩下壳组成灯罩。

[0006] 优选的,所述灯罩上壳和灯罩下壳的外形均设置为环形。

[0007] 优选的,所述灯罩上壳和灯罩下壳均由PC材料制成。

[0008] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0009] 本实用新型通过灯罩上壳、LED芯片、灯罩下壳、凹槽相互配合,灯罩上壳和灯罩下壳组成灯罩,灯罩上壳和灯罩下壳之间通过扣接固定,使得灯罩容易拆装,LED芯片卡接在凹槽的内壁上,便于对LED芯片进行拆装,从而方便对LED芯片进行维护,使得对LED芯片的维护工作比较省时省力,降低了工作人员的劳动强度,并且在工艺上,制作简单,美观性好,亮光效果也好,给使用者带来极大的便利。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的分解结构示意图;

[0011] 图2为本实用新型的安装结构示意图;

[0012] 图3为本实用新型实施例1的结构示意图。

[0013] 图中:1灯罩上壳、2 LED芯片、3灯罩下壳、4凹槽。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-2，一种LED发光体，包括灯罩上壳1、LED芯片2、灯罩下壳3和凹槽4，灯罩下壳3设置在灯罩上壳1的底部，灯罩上壳1和灯罩下壳3之间通过扣接固定，凹槽4开设在灯罩下壳3的顶部，LED芯片2设置在凹槽4的内部，LED芯片2设置为一条环形的芯片，LED芯片2卡接在凹槽4内壁的底部。

[0016] 在具体实施的时候，灯罩上壳1和灯罩下壳3组成灯罩。

[0017] 在具体实施的时候，灯罩上壳1和灯罩下壳3的外形均设置为环形。

[0018] 在具体实施的时候，灯罩上壳1和灯罩下壳3均由PC材料制成。

[0019] 实施例1，图3中的LED芯片2设置为两条环形的芯片，两条LED芯片2分别卡接在凹槽4内壁的内侧和外侧。

[0020] 使用时，通过灯罩上壳1、LED芯片2、灯罩下壳3、凹槽4相互配合，灯罩上壳1和灯罩下壳3组成灯罩，灯罩上壳1和灯罩下壳3之间通过扣接固定，使得灯罩容易拆装，LED芯片2卡接在凹槽4的内壁上，便于对LED芯片2进行拆装，从而方便对LED芯片2进行维护，使得对LED芯片2的维护工作比较省时省力，降低了工作人员的劳动强度，并且在工艺上，制作简单，美观性好，亮光效果也好，给使用者带来极大的便利。

[0021] 尽管已经出示和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

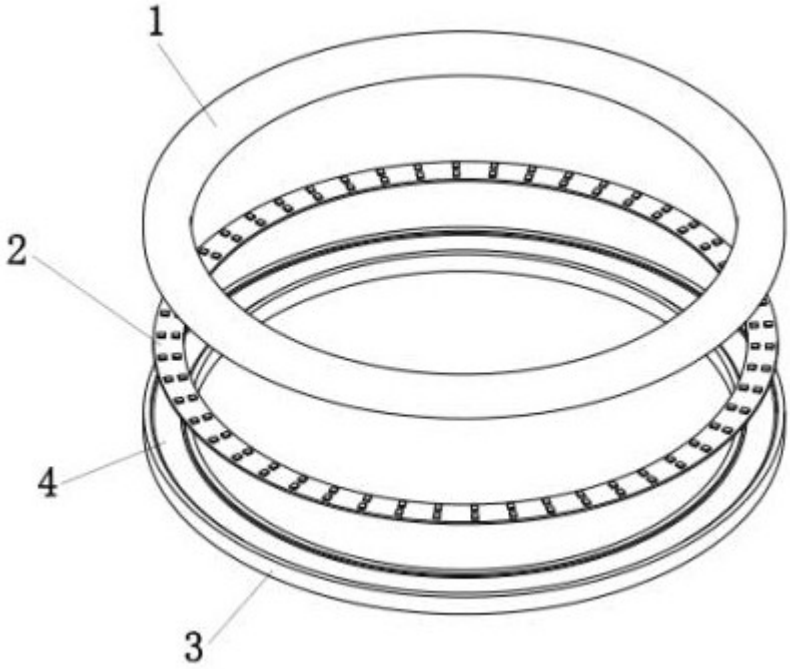


图1

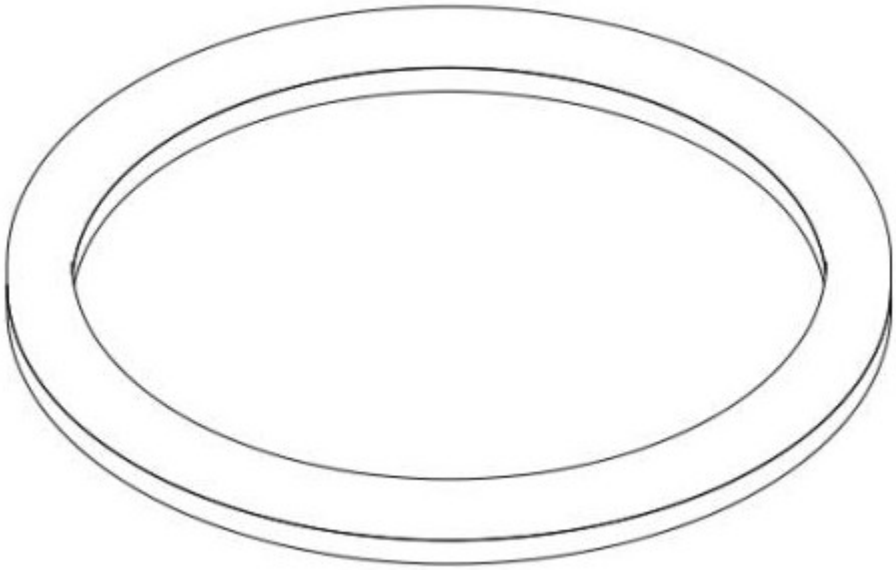


图2

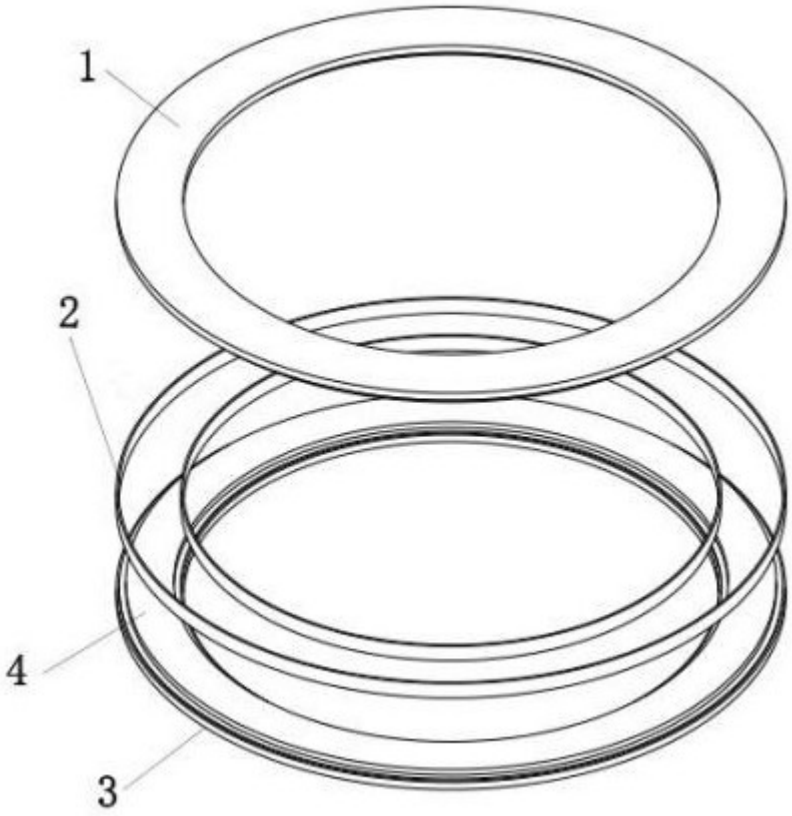


图3